



上品綜合工業股份有限公司

股票代號：4770

2022年度第1季法人說明會

May 20th, 2022

免責聲明

本簡報及同時發佈之預測性資訊，皆基於當前情況之預期以及對未來事件的預測，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。

預測性資訊依然受未知的風險、不確定因素以及其他因素之影響，故本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況，業務展望以及營運擴張，可能與預測性資訊有所差異。

簡報目錄 Contents

1. 經營績效 (Operation Performance)

劉彥志財務長

2. 營運展望 (Business Outlook)

李遠忠執行長

3. Q & A



01

經營績效

季度合併綜合損益表

新台幣仟元

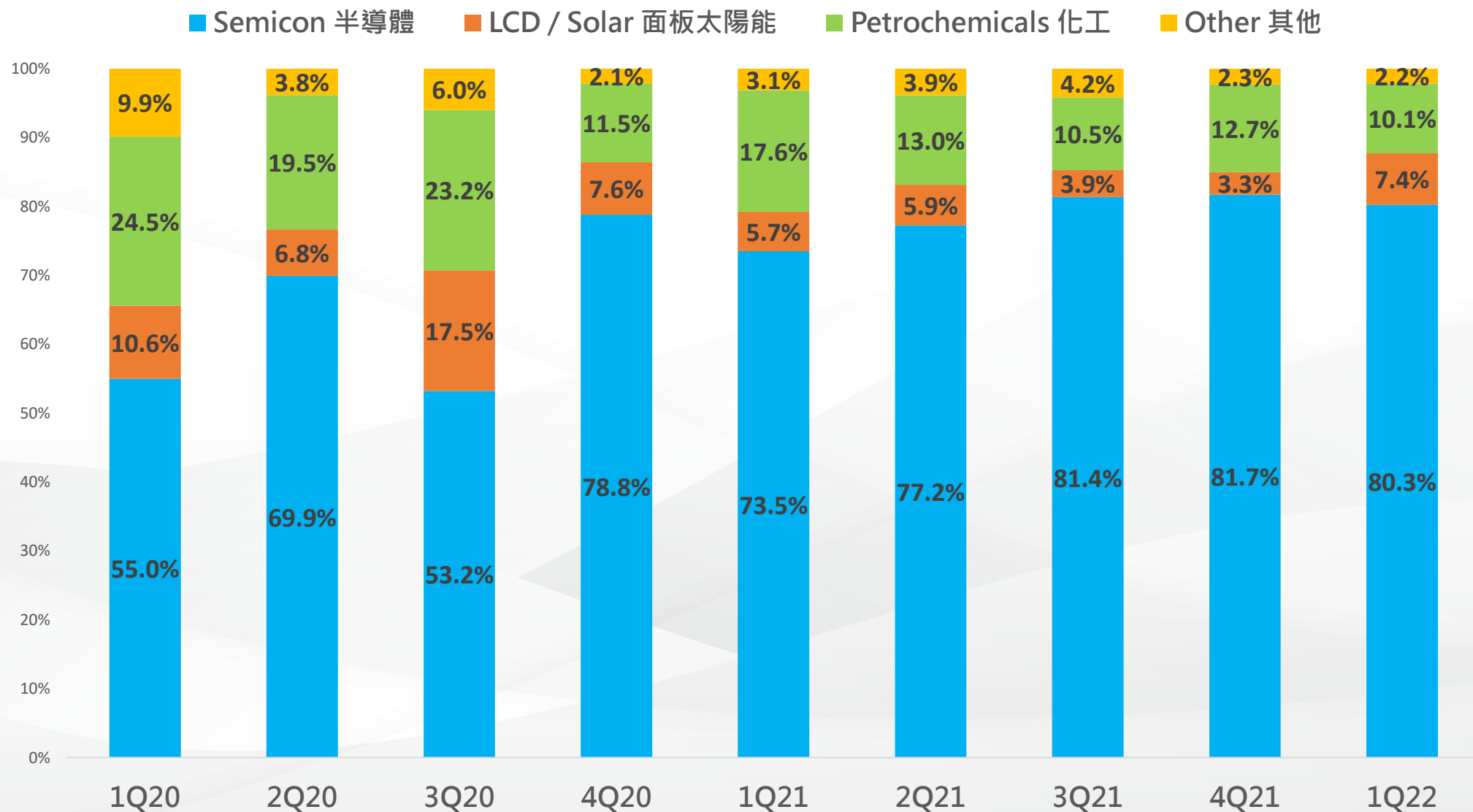
損益項目	1Q22 (核閱)	4Q21 (查核)	QoQ	1Q21 (核閱)	YoY
營業收入淨額	1,384,272	1,136,124	21.8%	763,472	81.3%
營業毛利	577,406	489,046	18.1%	340,692	69.5%
營業費用	153,010	160,303	-4.5%	99,517	53.8%
營業淨利	424,396	328,743	29.1%	241,175	76.0%
營業外收支	20,954	12,281	70.6%	(4,999)	519.2%
稅前淨利	445,350	341,024	30.6%	236,176	88.6%
所得稅費用	85,893	53,617	60.2%	44,406	93.4%
本期淨利	359,457	287,407	25.1%	191,770	87.4%
每股盈餘	4.58	4.09	0.49	2.79	1.79
損益項目	1Q22	4Q21	QoQ	1Q21	YoY
毛利率	41.7%	43.0%	-1.3%	44.6%	-2.9%
營業費用率	11.1%	14.1%	-3.1%	13.0%	-2.0%
營業利益率	30.7%	28.9%	1.7%	31.6%	-0.9%
業外收支率	1.5%	1.1%	0.4%	-0.7%	2.2%
稅前淨利率	32.2%	30.0%	2.2%	30.9%	1.2%
純益率	26.0%	25.3%	0.7%	25.1%	0.8%

合併資產負債表 & 關鍵指標

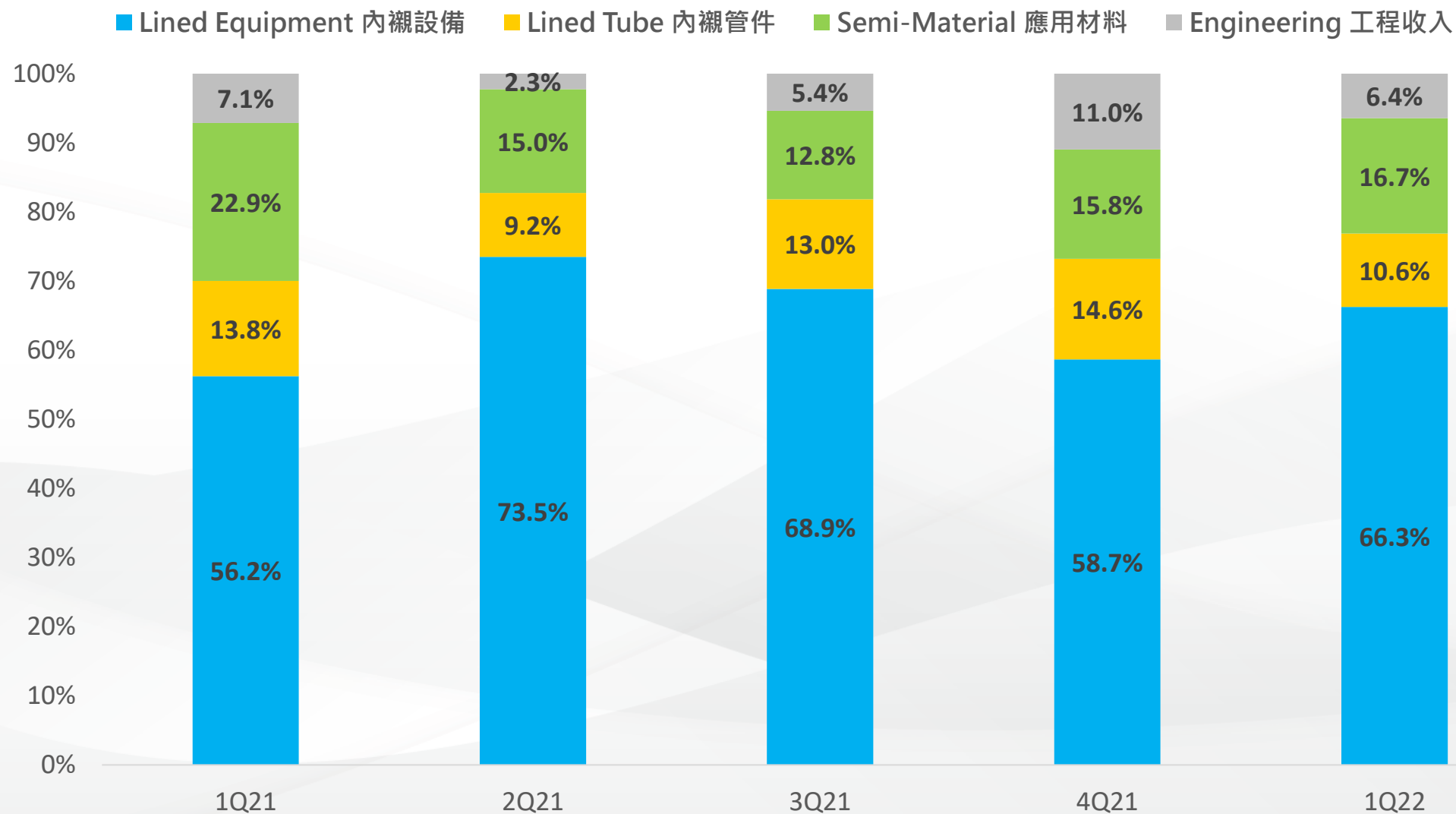
新台幣仟元

資產負債表項目	1Q22 (核閱)		4Q21 (查核)		1Q21 (核閱)	
	Amount	%	Amount	%	Amount	%
現金及銀行存款	3,818,536	44.3%	3,720,403	45.6%	952,816	19.8%
應收票據及帳款	1,188,496	13.8%	1,029,326	12.6%	896,996	18.6%
存貨	1,503,955	17.4%	1,380,310	16.9%	926,049	19.2%
其他金融資產-流動	300,775	3.5%	290,595	3.6%	428,394	8.9%
其他流動資產	186,445	2.2%	193,364	2.4%	295,828	6.1%
不動產、廠房及設備	1,495,545	17.3%	1,428,231	17.5%	1,201,524	24.9%
其他非流動資產	126,371	1.5%	109,820	1.3%	119,008	2.5%
資產總計	8,620,123	100.0%	8,152,049	100.0%	4,820,615	100.0%
流動負債	2,662,413	30.9%	1,982,183	24.3%	1,439,027	29.9%
非流動負債	625,056	7.3%	633,126	7.8%	343,580	7.1%
負債總計	3,287,469	38.1%	2,615,309	32.1%	1,782,607	37.0%
股東權益總計	5,332,654	61.9%	5,536,740	67.9%	3,038,008	63.0%
平均收現日數	73		94		108	
平均銷貨日數	163		188		193	
流動比率	263%		334%		243%	
負債比率	38%		32%		37%	

季度營業收入 by 產業別

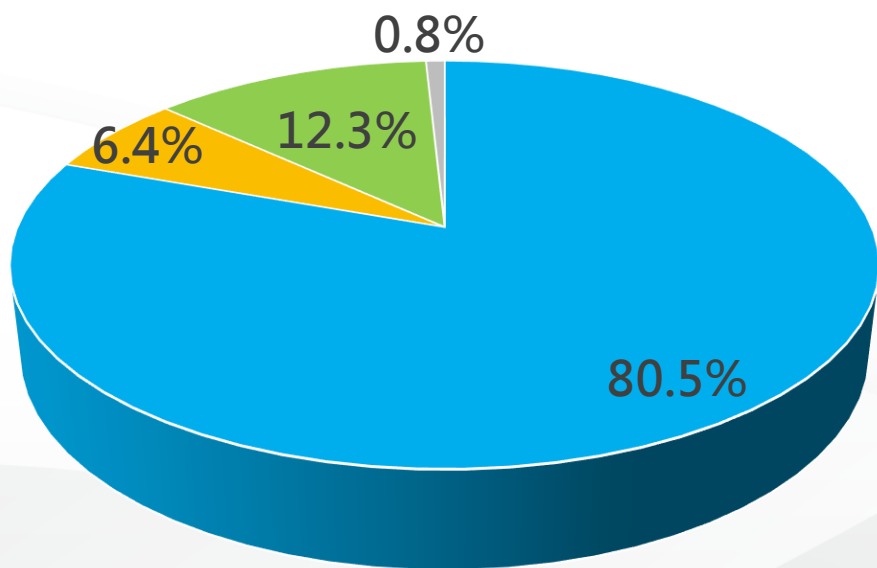


季度營業收入 by 產品別



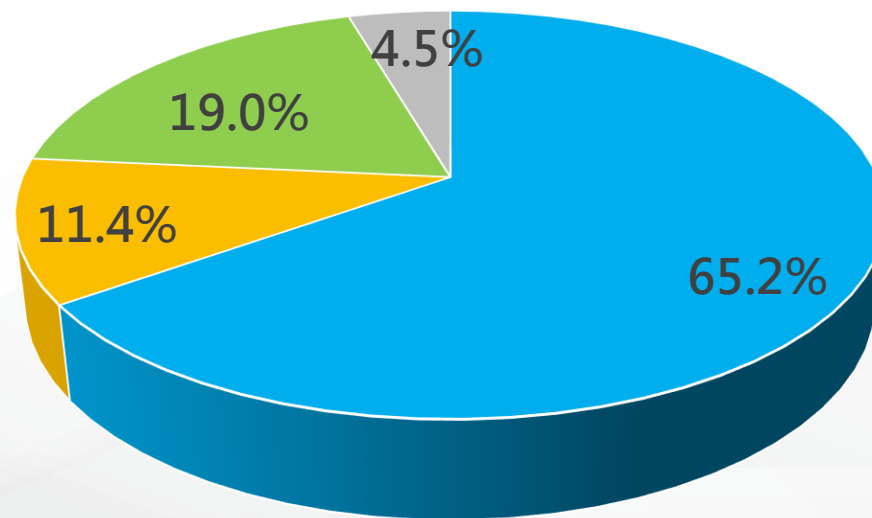
22/04單月營業收入(NT\$ 538,387仟元)

22/04 產業別營收 Revenue by Industries



- Semicon 半導體
- Petrochemicals 化工
- LCD / Solar 面板太陽能
- Other 其他

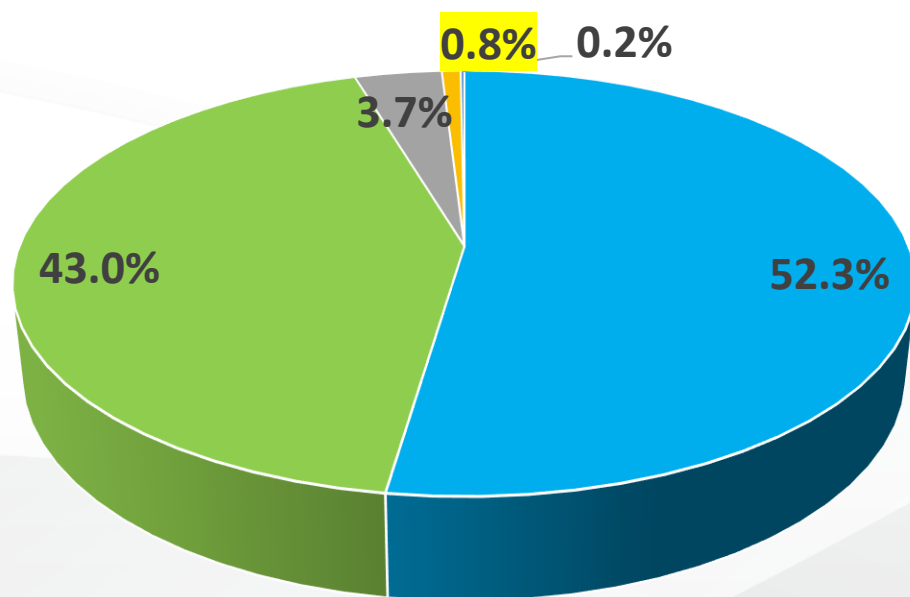
22/04 產品別營收 Revenue by Products



- Lined Equipment 內襯設備
- Semi-Material 應用材料
- Lined Tube 內襯管件
- Engineering 系統工程

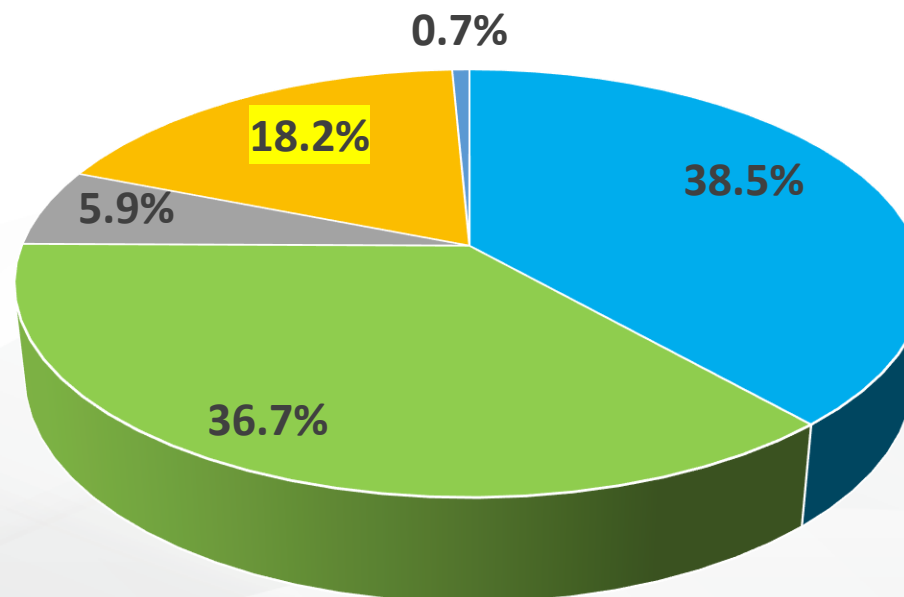
前4個月美國地區營收大幅成長 (0.8% → 18.2% 台、美系半導體客戶)

FY2021 地區別營收 Revenue by Area



■ Taiwan ■ China ■ Other Asia ■ America ■ Europe

22/ 01-04 地區別營收 Revenue by Area



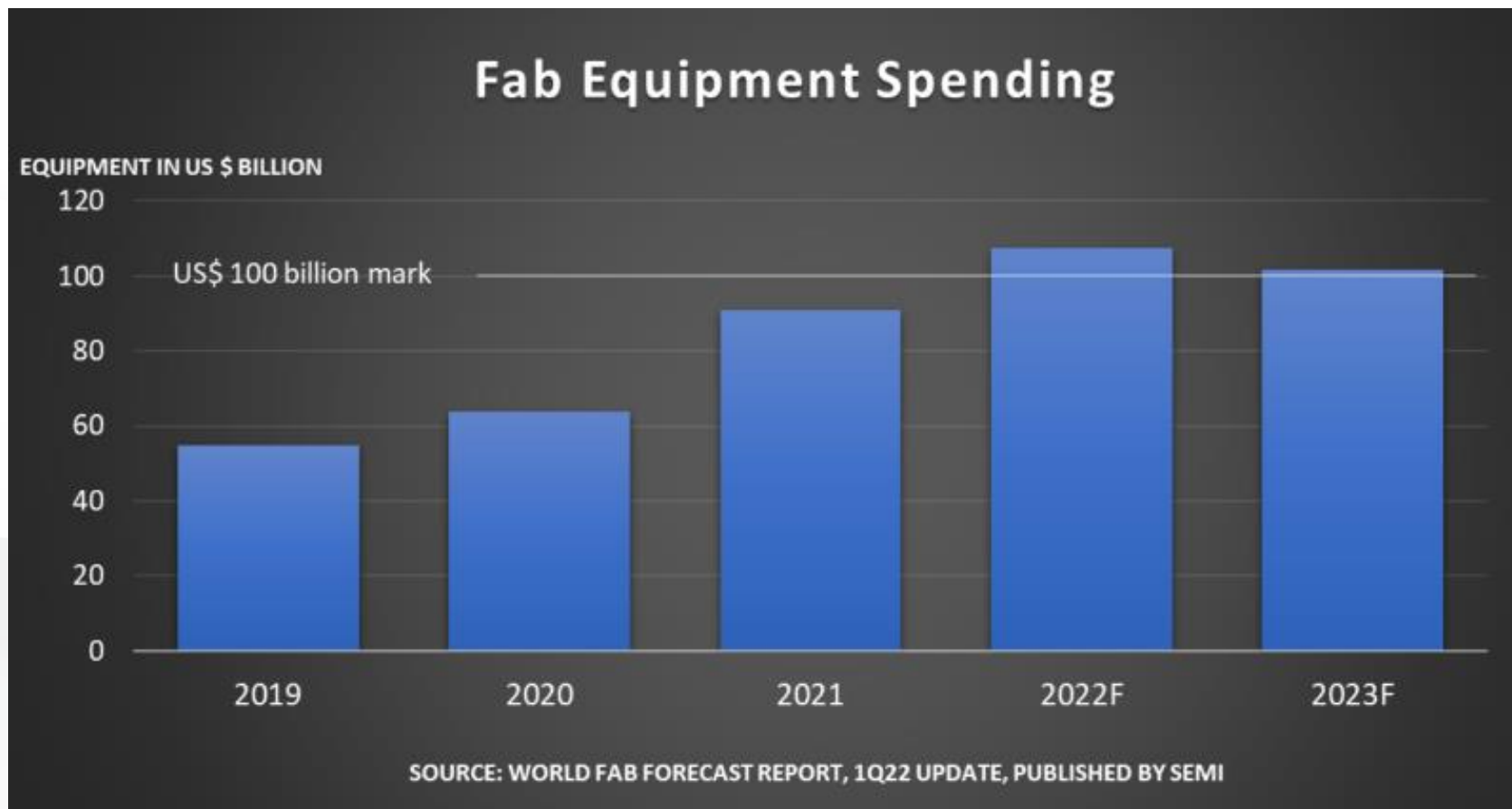
■ Taiwan ■ China ■ Other Asia ■ America ■ Europe



02

營運展望

全球半導體發展 / 2022年全球晶圓廠設備支出



https://www.semi.org/zh/press_release/world_fab_forecast/2022_q1



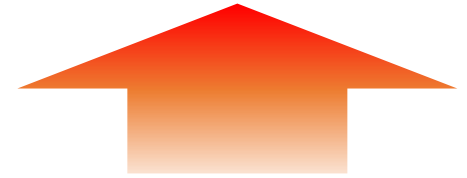
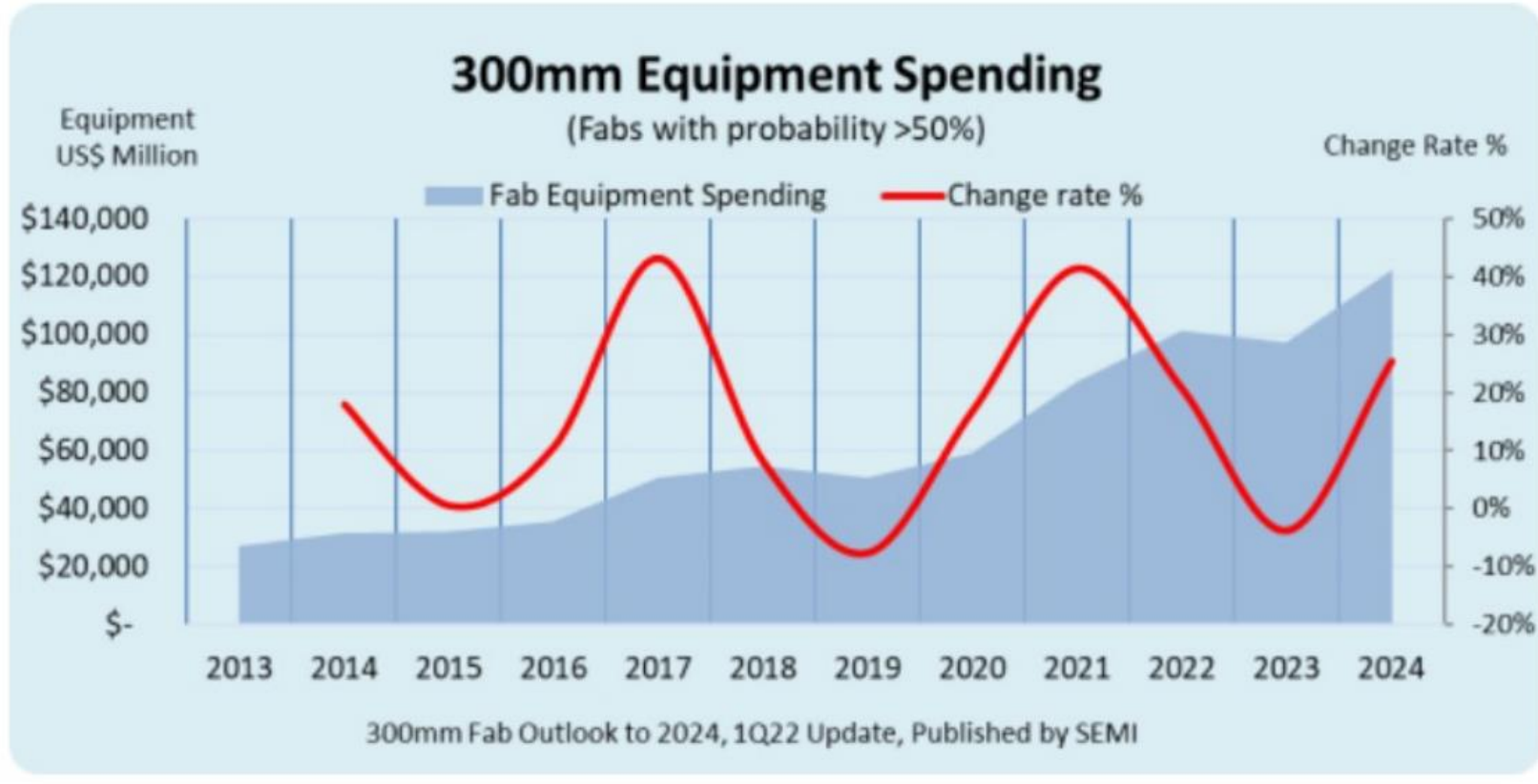
新晶圓廠建置可望帶動設備支出大幅增加

2022年晶圓廠設備支出

- 台灣：總額較去年成長56%來到350億美元
- 韓國：增幅9%、總額260億美元
- 中國：支出總額達 175億美元
- 歐洲/中東地區：支出可望創歷史紀錄，達96億美元，同比成長衝248%

<https://www.eettaiwan.com/20220324nt21-fab-equipment-spending/>

全球半導體發展 / 12吋晶圓廠設備支出展望

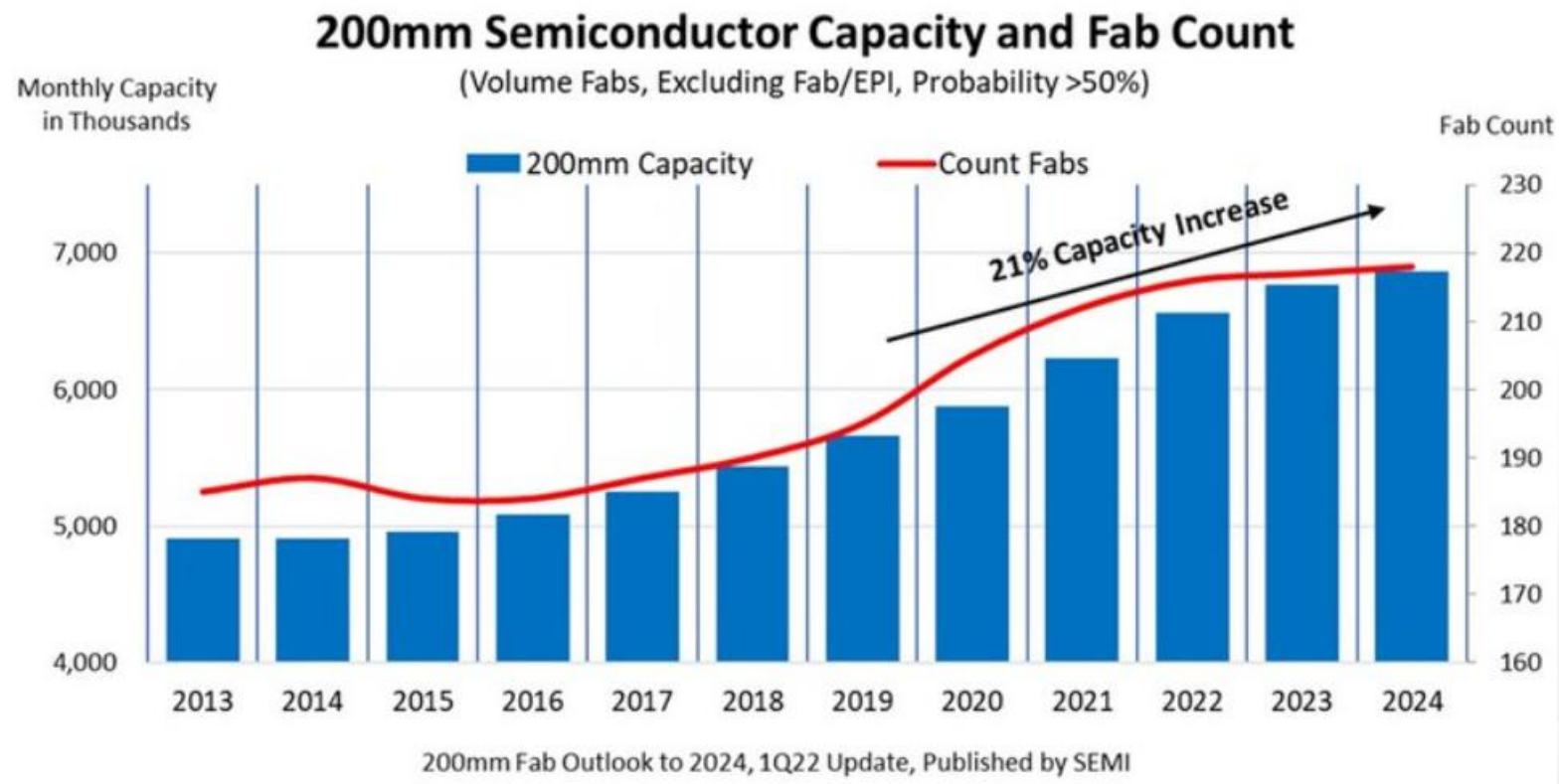


2022年 12吋晶圓廠資本支出
預估達1,000億美金， 2024年
預估上看1200億美金

資本支出持續增加，連動拉升
電子化學相關氟素設備需求

<https://www.semi.org/en/products-services/market-data/300mm-fab-outlook>

全球半導體發展 / 8吋晶圓廠產能將增加21%



200mm installed semiconductor capacity and fab count, 2013 to 2024*, * Fab count is net of wafer-size conversions.

「晶圓製造商將在五年內增加 25 條新的 200 毫米生產線，以幫助滿足 5G、汽車和物聯網 (IoT) 設備等依賴於模擬、電源管理和顯示驅動器集成電路等設備的應用不斷增長的需求。IC)、MOSFET、微控制器單元 (MCU) 和傳感器」 - Ajit Manocha, SEMI president and CEO.

21% ↑

從 2020 年初到 2024 年底，
全球半導體製造商有望 8 吋晶
圓廠產能提高 120 萬片

49 億美元 ↑

預計 2022 年 8 吋晶圓廠設
備支出將達到 49 億美元



03

Q & A